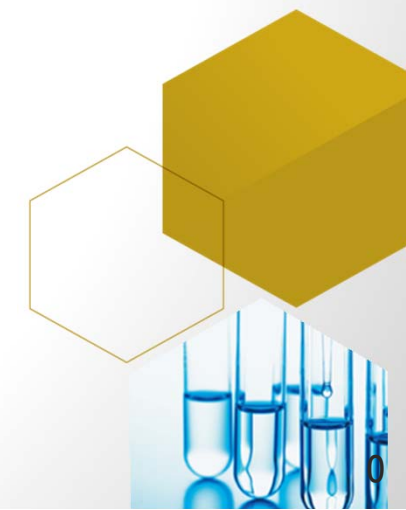
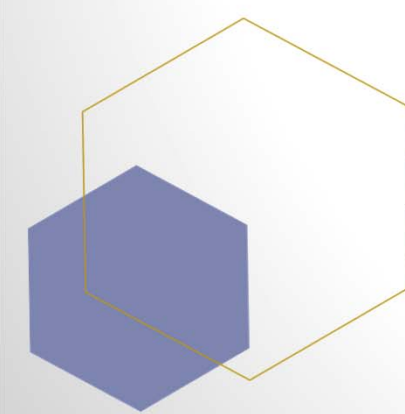





2019年3月期 決算説明資料



 日本高純度化学株式会社

証券コード:4973

2018年10月23日



会社紹介

沿革

- 1971年7月 会社設立
- 1999年11月 MBOを実施
- 2002年12月 JASDAQ市場に上場
- 2004年3月 東京証券取引所市場第二部に上場
- 2005年3月 東京証券取引所市場第一部に指定

事業概要

- 電子部品業界の発展を支える電子材料を供給するファインケミカル企業
- 事業のターゲットを貴金属めっき工程に絞り世界シェアトップ
- 変化の激しい業界にスピーディーに対応できる販売体制と技術サポート体制を構築
- 大規模な製造プラントを必要としないファブレス企業
- 電子部品の接続に用いる貴金属の使用量を最小限に抑える技術を提供し、資源の有効利用に貢献

電子部品業界の状況

- 自動車の電装化やデジタル家電、エッジコンピュータなどIoT化へ向けて新しい需要が高まってきている。
- 牽引役であるスマートフォンについては、高性能カメラ、OLED、非接触充電、画像認証など、高機能化へ向けて性能向上が進んでいる。
- 高機能化に伴い高価格帯となったことから、買い替え需要は鈍化傾向となっている。

当社決算の概況

- 底堅い電子部品需要に支えられて引き続き好調に推移した。
- ワイヤーボンディング用純金めっき薬品の販売はパソコンの買い替え需要、メモリー向け半導体需要に支えられて堅調に推移した。
- パッケージ基板やスマートフォン向けの無電解めっき薬品については、スマートフォンの高機能化に伴い技術的優位性から好調に推移した。
- リードフレーム用パラジウムめっき薬品については、昨年からのパラジウム価格高騰に伴う懸念から販売量の鈍化傾向が見受けられた。

2019年3月期 第2四半期決算概況

(単位:百万円、%)

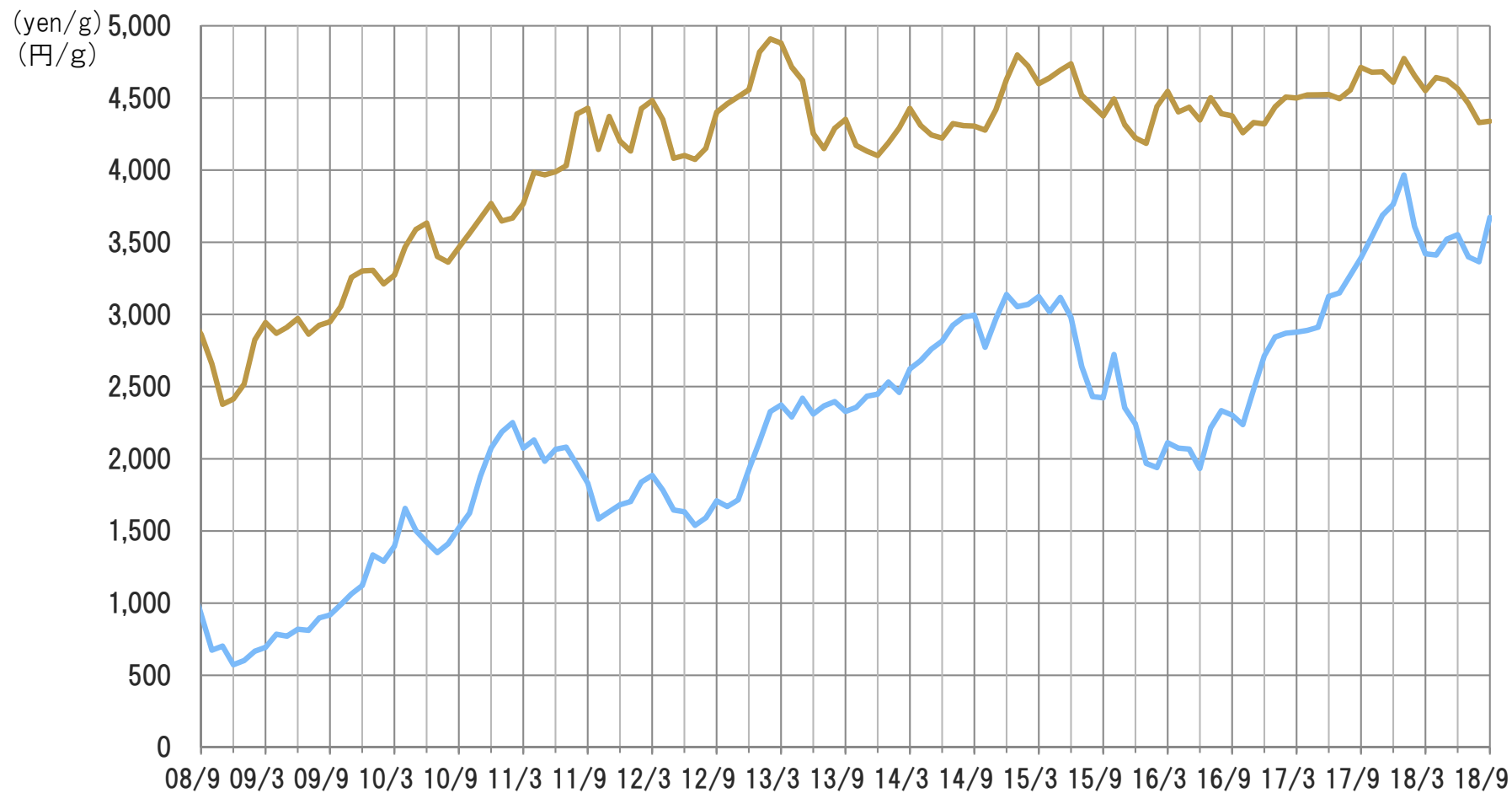
| | 2018/3期 1Q~2Q | 2019/3期 | | | | 2019/3期予想 | |
|----------------|------------------|---------|--------|--------|------|-----------|------|
| | | 1Q | 2Q | 1Q~2Q | 増減率 | | 達成率 |
| 売上高 | 5,031 | 2,925 | 2,573 | 5,498 | 9.3 | 10,200 | 53.9 |
| 営業利益 | 551 | 273 | 276 | 550 | △0.2 | 1,130 | 48.7 |
| 経常利益 | 602 | 343 | 282 | 626 | 3.8 | 1,230 | 50.9 |
| 純利益 | 422 | 251 | 203 | 455 | 7.8 | 860 | 52.9 |
| 1株当たり 当期純利益 | 73.48円 | 43.71円 | 35.32円 | 79.02円 | — | 149.36円 | — |

メタル相場推移

Prices of gold and palladium
金、パラジウム価格

Gold
金

Palladium
パラジウム

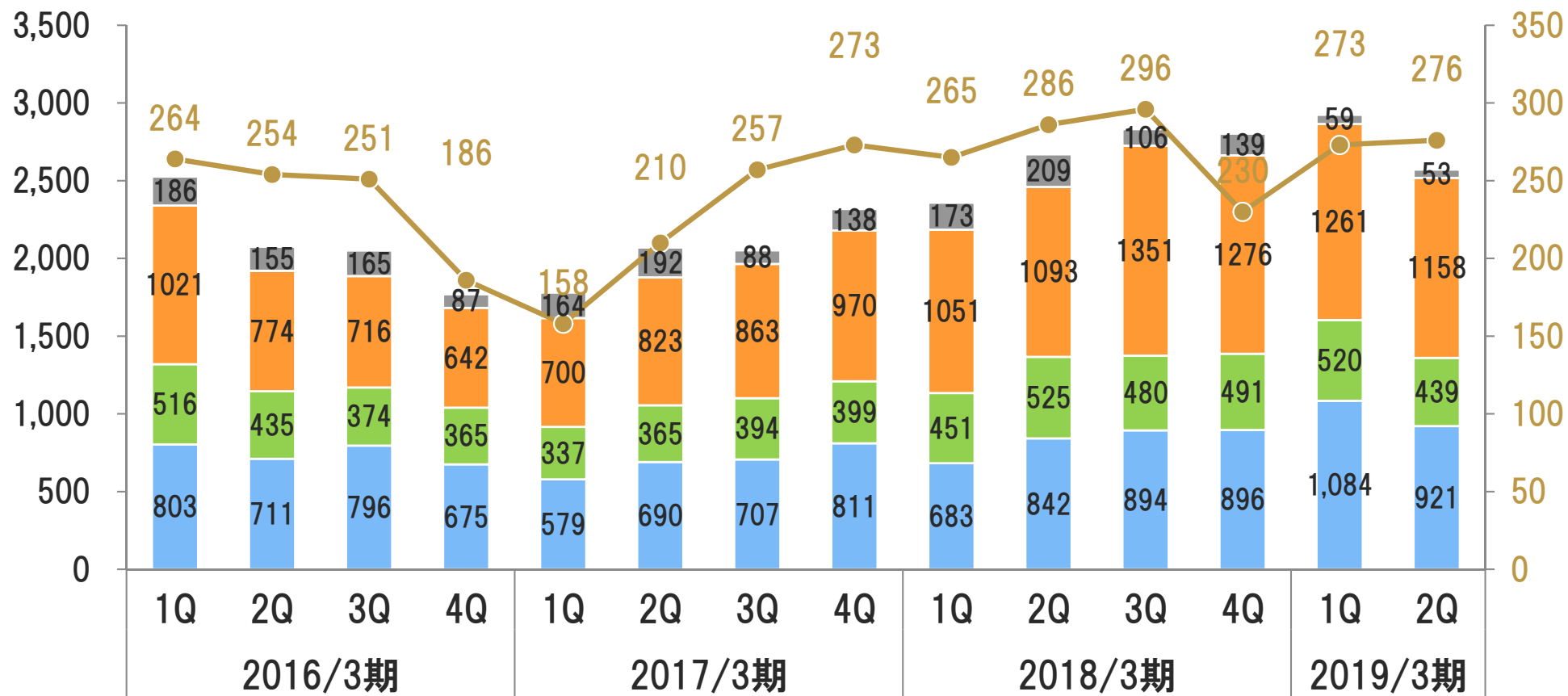


売上高・営業利益の推移(四半期ベース)

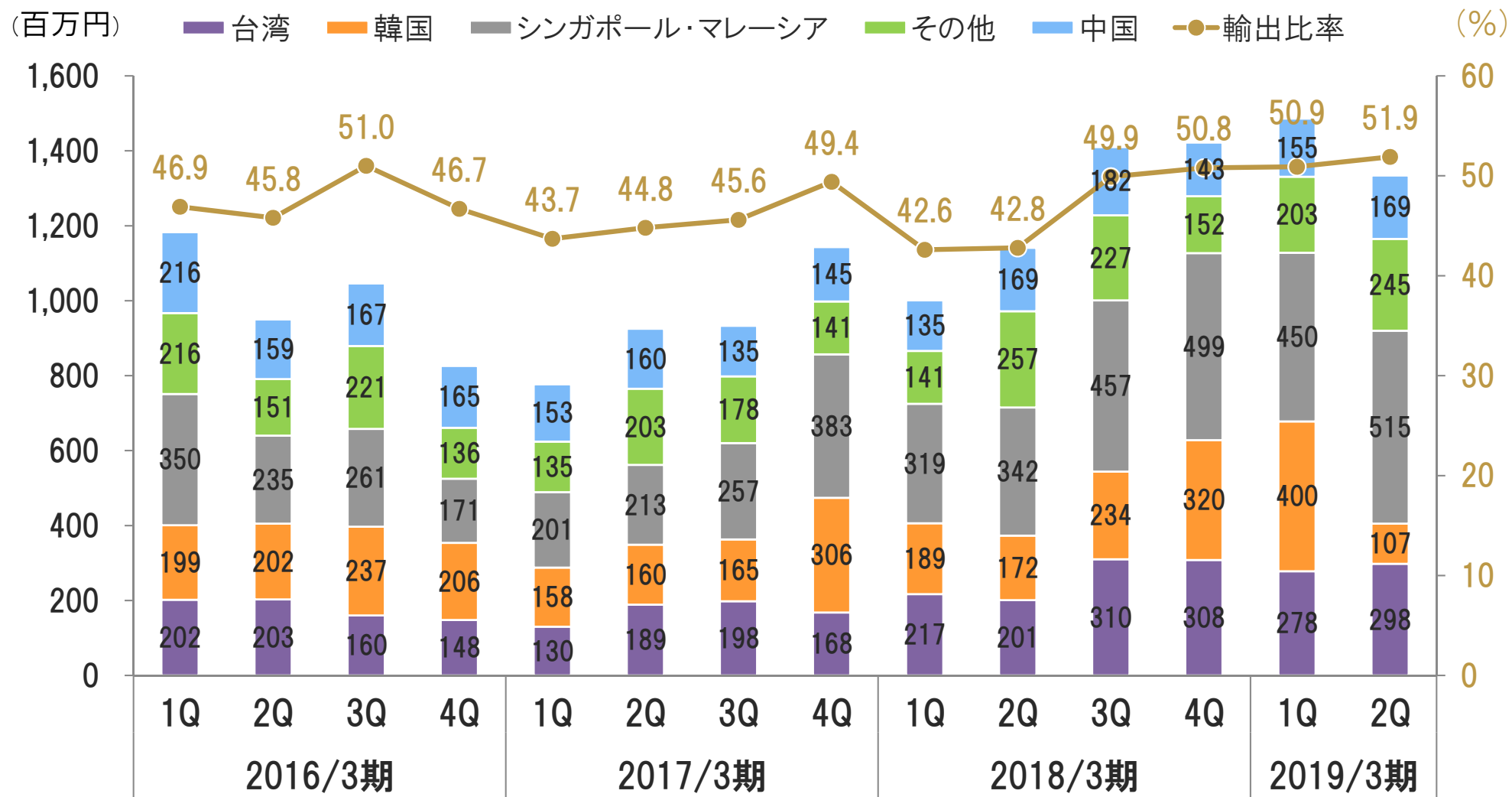
(百万円)

- プリント基板・半導体搭載基板用
- コネクター・マイクロスイッチ用
- リードフレーム用
- その他
- 営業利益

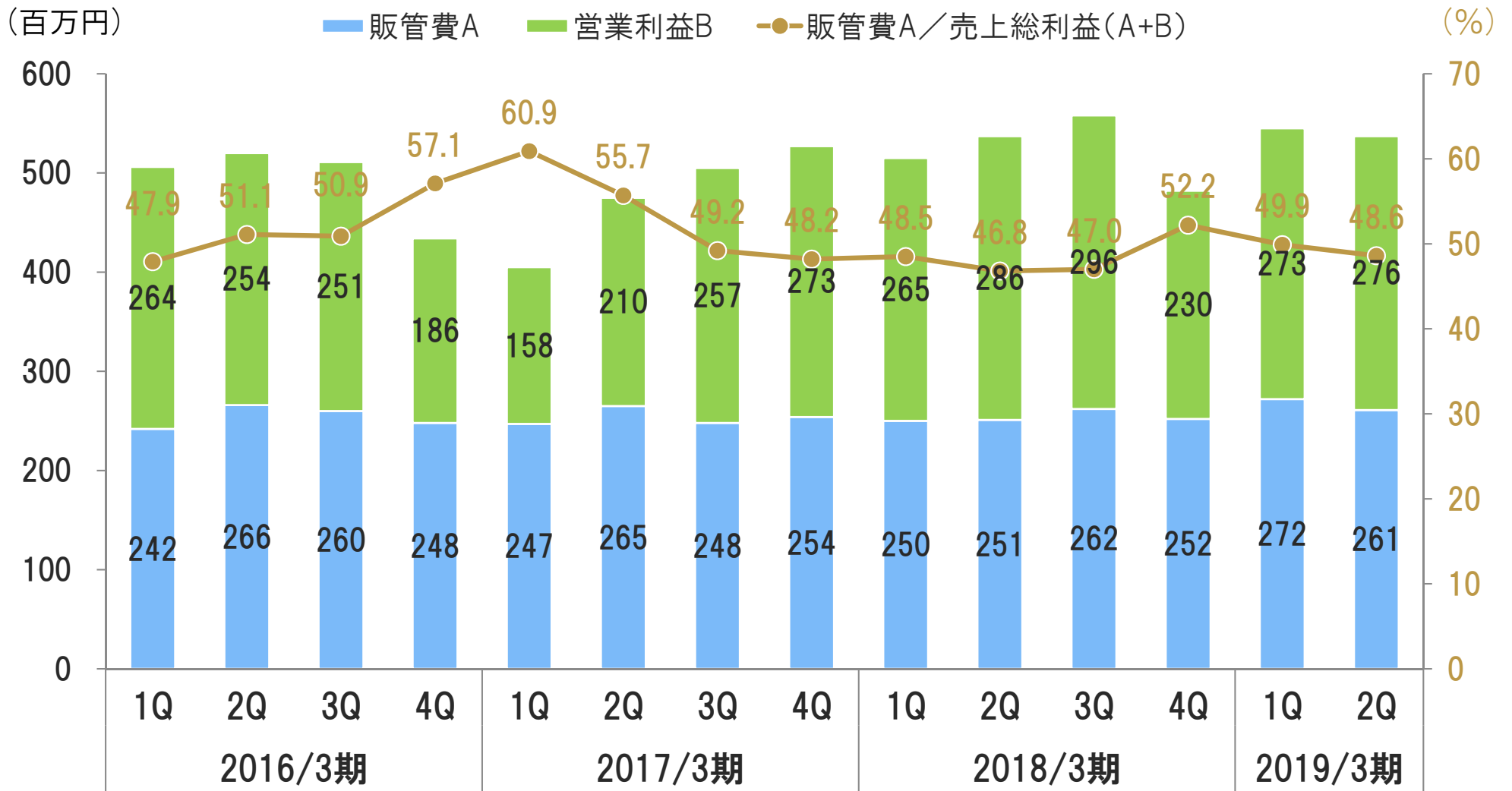
(百万円)



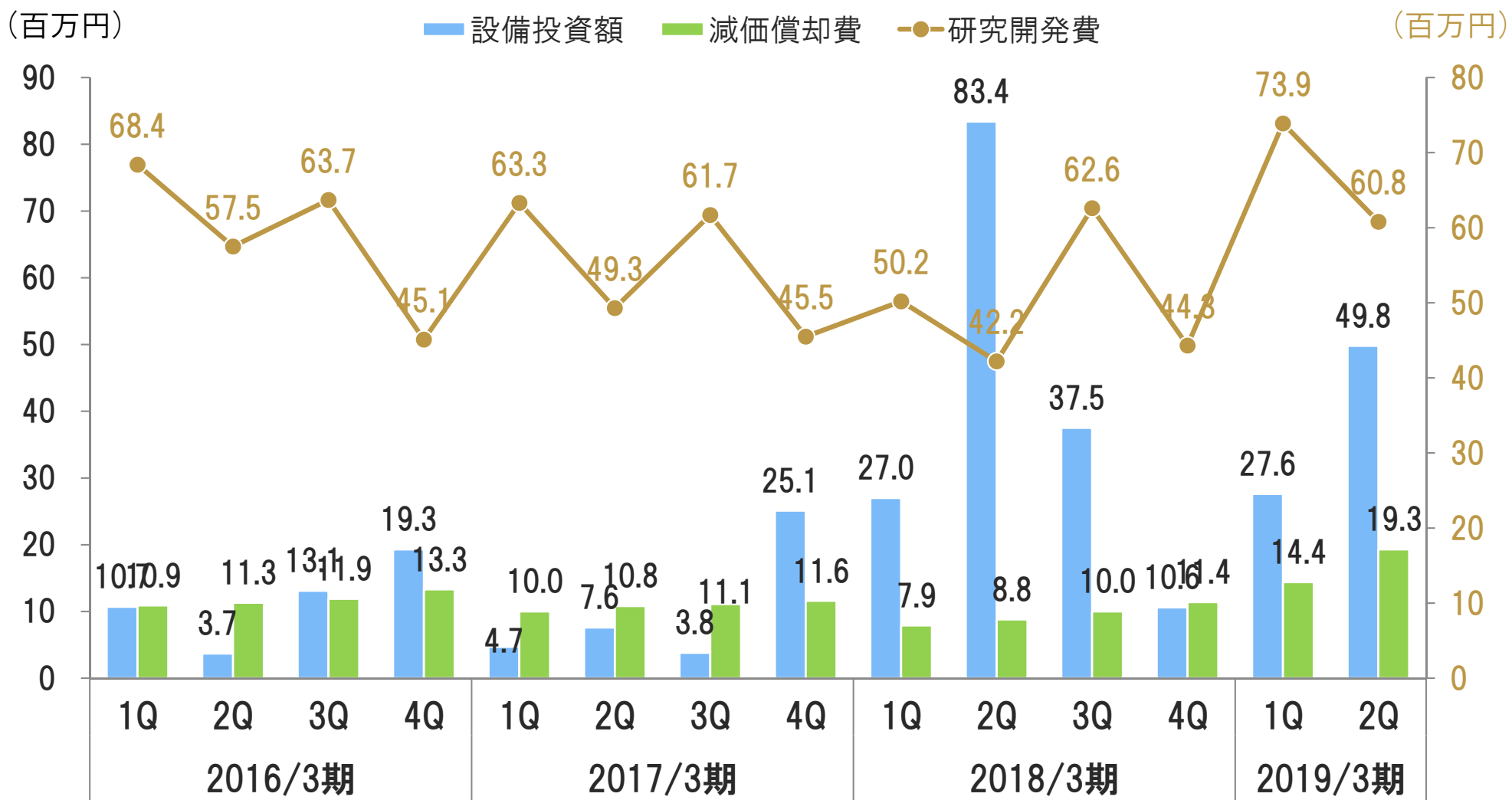
輸出地域別売上高の推移(四半期ベース)



販売管理費および営業利益の推移



設備投資額、減価償却費および研究開発費の推移



配当政策およびESG情報

1株当たり配当金

(単位:円、%)

| | 通期 | EPS | 配当性向 |
|-------------|----|--------|------|
| 2015/3期 | 80 | 131.87 | 60.7 |
| 2016/3期 | 80 | 121.31 | 65.9 |
| 2017/3期 | 80 | 124.44 | 64.3 |
| 2018/3期 | 80 | 144.13 | 55.5 |
| 2019/3期(予想) | 80 | 149.36 | 53.6 |

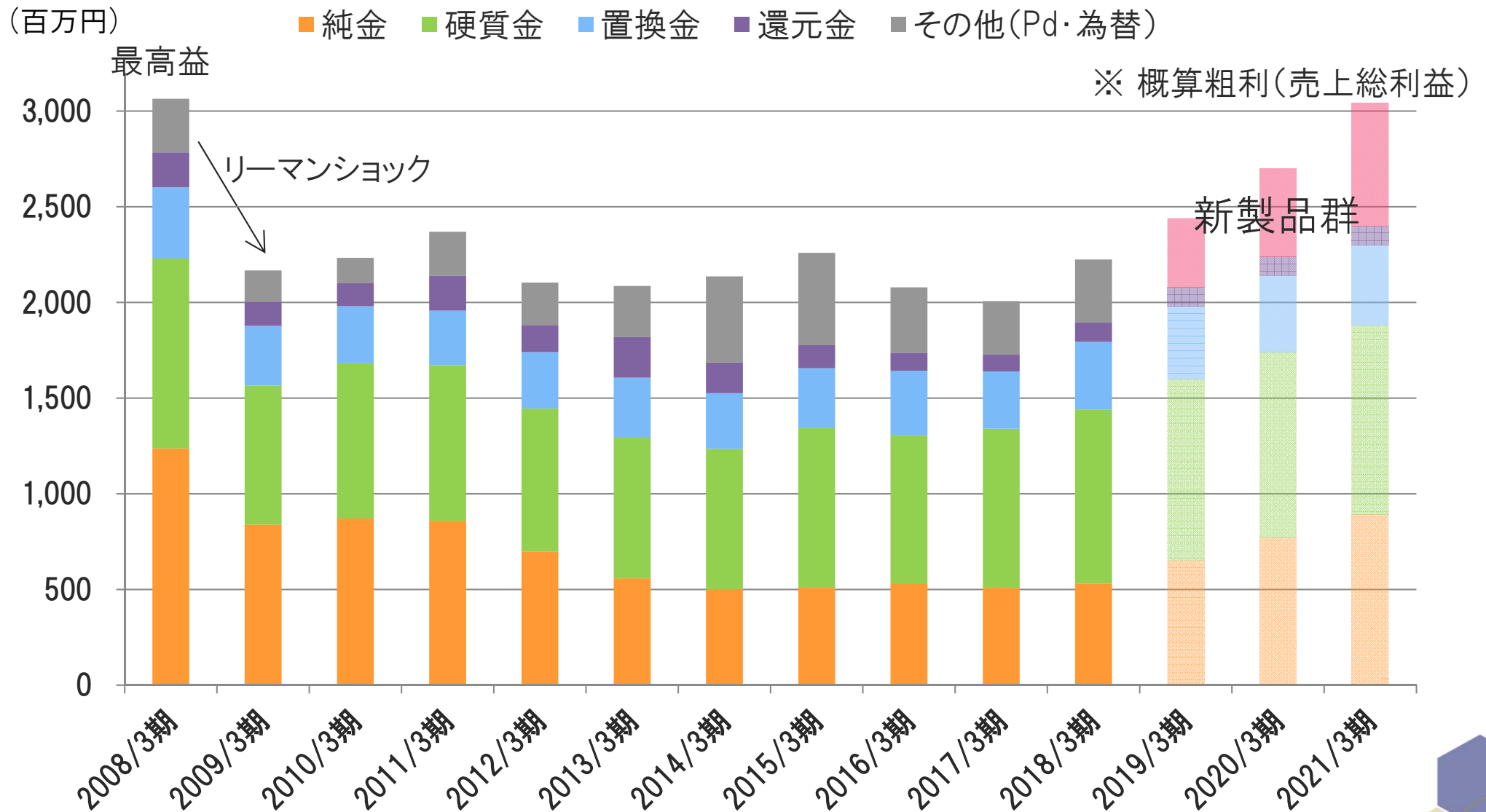
ESGに関する取り組み

- **環境配慮**・・・限られた貴金属資源の有効利用のため、省金製品を顧客に訴求
- **社会貢献**・・・CSRガイドラインを策定し、重点仕入先との共有を図る(年内予定)
- **ガバナンス強化**・・・改訂CGコードを踏まえたCGに関する報告書を開示(年内予定)

製品ラインアップ ~ラインアップ拡充と新分野開拓~

| | めっき方式 | 用途 | 製品ラインアップ | |
|-----|--------------|---|---|---------------------|
| 電解 | 純金 |  | ① 粗面上でも均一な膜厚が得られる純金めっき ② 硬度の高い純金めっき | |
| | 硬質金 (金合金) |  | マイクロコネクタ用省金硬質金めっき オーロブライト BAR7 | |
| | 電解Pd |  | PPF用薄膜パラジウムめっき パラブライト NANO2 | |
| 無電解 | 置換金 |  | 低金濃度で使える置換金めっき IM-GOLD FG 下地ニッケルの腐食が少ない置換金めっき IM-GOLD CN | |
| | 還元金 |  | 亜硫酸金を使った薄膜還元金めっき HY-GOLD シアン化金を使った薄膜還元金めっき HY-GOLD CN | |
| | 還元Pd |  | ENEPIG用還元パラジウムめっき ネオパラブライト 2 ダイレクト 還元パラジウムめっき ネオパラブライト DP | |
| 新分野 | 新分野 | | 後処理剤 合金めっき | 還元Snめっき ビアフィルめっき |

めっき方式別利益計画



スマートフォン市場の深化

ハイエンドマーケットの実績をミドル・ローエンドマーケットへ展開

- 高速伝送に有利なダイレクトめっき(4Gから5Gへ)
- 従来のニッケルめっきを省くことで生産性向上、コスト削減に寄与

- ・DIG(銅上ダイレクト金)・・・ENIGに代わる高周波特性・高解像度対応プロセス
- ・EPIG(銅上ダイレクトパラジウム/金)・・・巨大なIoT市場に展開

ハイエンドマーケット



ミドル・ローエンドマーケット

成熟市場

競合企業の主戦場

→ 高シェアの維持

→ 提携商社との連携により海外拠点を中心に拡販



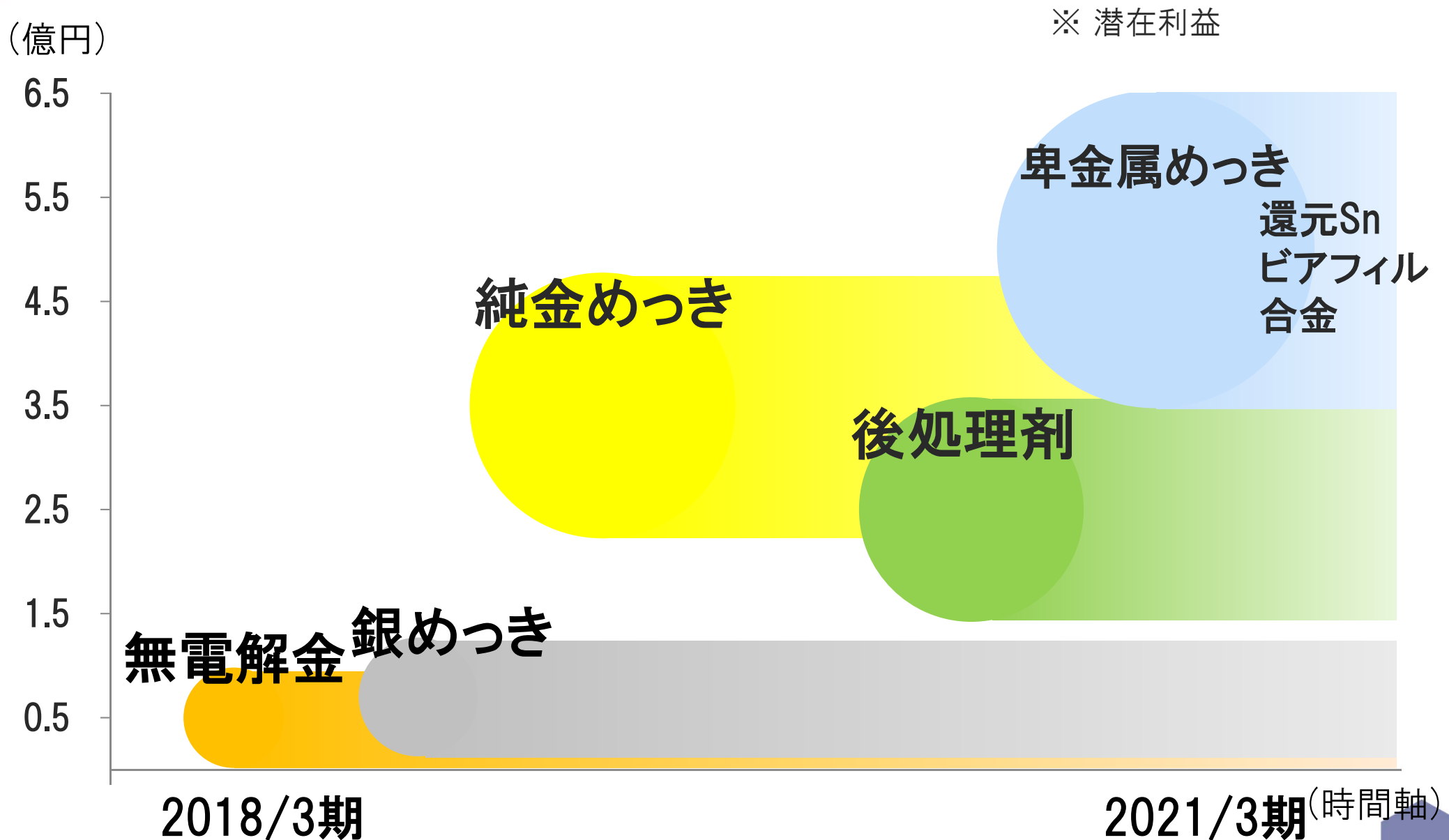
電子部品業界の動向

電子部品の主軸がスマートフォンから様々な産業へ

- スマートフォンの小型化・薄型化・軽量化で培われた技術が様々な用途に展開
- 高い信頼性が要求される用途には貴金属めっきが必須
- 当社めっき技術は電気を用いるあらゆる産業分野に貢献可能

- ・ **デジタル家電**・・・4K-TV、IoT家電、AIアシスタントなど
- ・ **携帯端末**・・・スマートウォッチ、タブレットなど
- ・ **ITインフラ**・・・基地局、サーバー、監視カメラなど
- ・ **ロボティクス**・・・産業機械、ロボットなど
- ・ **自動車**・・・電動化・電装化、車載機器、自動運転など
- ・ **医療・ヘルスケア**・・・ネットワーク化、遠隔医療のシステム化など

利益貢献が見込まれる新製品群



研究開発型企業としての新技術探索

貴金属めっきにおける固有技術

- めっきされる基材表面を制御する“Protecting Agent”（※）

※特定の金属に選択的に吸着し、電子を供与又は求引する効果によって、めっき反応や皮膜物性をコントロールする一連の有機化合物

卑金属めっきや合金めっきにおける新技術

- めっき膜厚が貴金属めっきの100倍以上になり、めっき皮膜の結晶配向を制御しつつ、大幅な速度向上が必要
- ➡新技術“Charge Transfer Agent”（※）を適用する計画

※めっき液中の電荷を速やかに移動し、めっき反応を促進させる一連の有機化合物

分子構造に“Protecting Agent”や“Charge Transfer Agent”の機能を有する化合物を探索し、次世代の柱となる新製品を開発する。

通期の見通し

(単位:百万円、%)

| | 2018/3期 | | 2019/3期 | | | |
|-------|---------|-------|---------|--------|-------|------|
| | | 構成比 | 前期比 | 構成比 | 前期比 | |
| 売上高 | 10,668 | 100.0 | 29.6 | 10,200 | 100.0 | △4.4 |
| 営業利益 | 1,078 | 10.1 | 19.8 | 1,130 | 11.1 | 4.8 |
| 経常利益 | 1,179 | 11.1 | 17.6 | 1,230 | 12.1 | 4.3 |
| 当期純利益 | 829 | 7.8 | 15.7 | 860 | 8.4 | 3.7 |

トピックス

- **貴金属パラジウム(Pd)**・・・地金価格の高騰への懸念からPd含有製品の売上高減少と予想
- **硬質金(金合金)**・・・マイクロコネクタ用硬質金めっきの改良製品の投入により、利益向上を見込む
- **ENIG(置換金)**・・・電子部品の世界の工場として伸長する東南アジア市場にて需要拡大
- **DIG(銅上ダイレクト金)**・・・ENIGに代わる高周波特性・高解像度対応プロセスとして拡販中
- **EPIG(銅上ダイレクトパラジウム/金)**・・・巨大なIoT市場に展開できるよう、技術・営業両面でフォロー中

いずれも業界動向や顧客ニーズに迅速に対応できるよう積極的に拡販活動をおこなっております。



注意事項・免責事項

当該資料で用いられている業績予想ならびに将来予測は、いずれも当社の事業に関連する業界の動向についての見通し、国内および諸外国の経済状況、ならびに為替レートの変動、その他の業績へ影響を与える要因について、2018年9月時点で入手可能な情報をもとにした予想を前提としています。

これらは、市況、競争状況、新製品およびサービスの導入およびその成否、ならびに情報通信関連産業の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。よって、実際の業績は配布資料および決算説明で用いる予想数値とは、大きく異なる場合があることをご了解いただきますようお願い致します。

この資料の著作権は日本高純度化学株式会社に帰属します。いかなる理由によっても、当社に許可なく資料を複製・配布することを禁じます。

お問い合わせ先

TEL. 03-3550-1048 FAX. 03-3550-1006

経営企画部

<https://www.netjpc.com>